

檔 案：

保存年限：

勁園國際股份有限公司 函

地址：242新北市新莊區中正路651-3號5樓

傳真：(02)2908-6347

聯絡人：黃重景

聯絡人電話：(02)2908-5945分機881

電子信箱：rov@tiked.com.tw

受文者：全國各大專校院

發文日期：中華民國102年05月01日

發文字號：勁字第號1020501001號 速別：普通

附件：〈附件1・競賽活動簡章〉

主旨：敬邀 貴校師生參加「2013第一屆 ITM 創新科技設計大賽」，詳如說明，請 惠予公告。

說明：

- 一、2013第一屆 ITM 創新科技設計大賽，目的在提升學生與教師設計實作與創新研發之能力。
- 二、本活動分為PCB創意電路板設計類、IRA智慧型機器人類、AMA先進微控制器設計類，每競賽類別皆分為高中職組、大專組與教師組等。
- 三、獎勵方式個科目與各組別，各取前3名等。

正本：全國各大專校院研發處

副本：台灣創新科技管理發展協會、勁園國際股份有限公司、台科大圖書股份有限公司、盛群半導體有限公司、台灣圖研有限公司、利基應用科技有限公司、
Make: Taiwan

總經理 范文豪